

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2008 年 4 月 24 日 (24.04.2008)

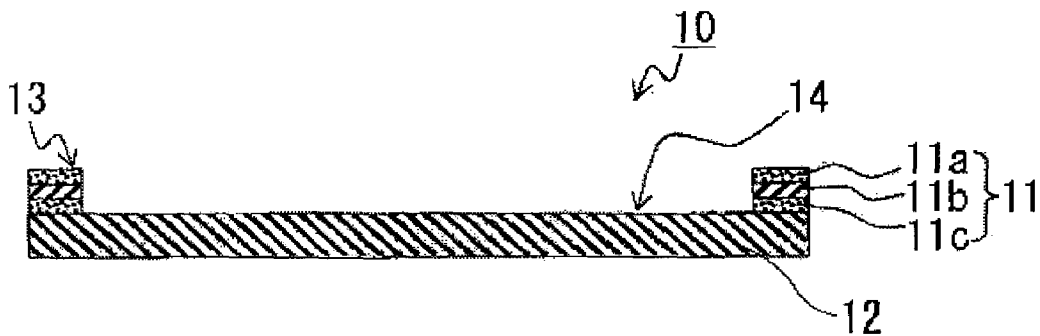
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2008/047708 A1

- (51) 国際特許分類:
B65D 85/86 (2006.01) H01L 21/683 (2006.01)
B65D 73/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2007/069958
- (22) 国際出願日: 2007 年 10 月 12 日 (12.10.2007)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2006-286651
2006 年 10 月 20 日 (20.10.2006) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 番 2 3 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 濱崎 昭枝 (HAMASAKI, Akie) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 森谷 志乃 (MORITANI, Shino) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 小宮山 幹夫 (KOMIYAMA, Mikio)
- [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 鈴木 俊一郎 (SUZUKI, Shunichiro); 〒1410031 東京都品川区西五反田七丁目 1 3 番 6 号 五反田山崎ビル 6 階 鈴木国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ユーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書

(54) Title: SHEET FOR DIE SORT AND METHOD OF TRANSFERRING CHIP WITH ADHESIVE LAYER

(54) 発明の名称: ダイソート用シートおよび接着剤層を有するチップの移送方法



(57) Abstract: A sheet for die sort characterized by having a pressure sensitive adhesive layer exposed on a peripheral area of carrier sheet and having a substratum film exposed in a center area inside the peripheral area. There is provided a method of transferring a chip with adhesive layer, characterized by including providing the above sheet for die sort fixed by a frame member by means of the pressure sensitive adhesive layer of the peripheral area; temporarily adhering the adhesive layer of picked up chip to the substratum film exposed in the sheet for die sort; and transferring the sheet for die sort having the chip temporarily adhered by means of the adhesive layer to the subsequent step.

(57) 要約: 本発明のダイソート用シートは、キャリアシートの外周部に粘着剤層が表出され、前記外周部の内側である中央部に基材フィルムが表出されてなることを特徴とする。本発明の接着剤層を有するチップの移送方法は、前記外周部の粘着剤層を介して枠体で固定されている前記ダイソート用シートを用意し、前記ピックアップされたチップの接着剤層を、前記ダイソート用シートに表出される基材フィルムに仮着し、前記接着剤層を介して前記チップが仮着されたダイソート用シートを次工程に移送することを特徴とする。



WO 2008/047708 A1